News Release

2026 年 11 月 5 日

各　位

ＪＸ金属株式会社

高純度硫酸銅「ユピノーグ」の生産能力増強を決定
-茨城事業所(日立地区)内に製造ラインを増設し、先端半導体市場の成長需要に対応-

ＪＸ金属株式会社（社長：林　陽一、以下「当社」）は、高純度硫酸銅「ユピノーグ」の需要拡大に対応するため、当社茨城事業所（日立地区）内に製造ラインを増設し、生産能力を 2026 年度上期比で約 50%引き上げることを決定しました。新設備は 2027 年度下期より順次稼働を開始します。

「ユピノーグ」は当社独自の高純度化処理技術によって製造される高純度硫酸銅です。鉱石由来や排液由来の一般的な硫酸銅と比較して極めて低い不純物レベルを実現しており、高純度品の安定供給が可能です。これまで、プリント基板のスルーホール(※1)・ビアフィル(※2)用銅めっき液や半導体製造におけるダマシンプロセス(※3)向け材料として、多くのお客様に採用いただいています。当製品は、当社のめっき関連事業の中核製品の一つとして 40 年以上に渡り事業を継続しており、高純度化技術と安定供給体制を強みとして市場で高い評価をいただいています。足元では生成 AI 向けを中心とした先端半導体需要の拡大を背景に需要が増加しており、今後も成長が継続すると見込んでいます。特に半導体の高性能化・高集積化を支える先端パッケージング分野や、HBM(High Bandwidth Memory)などに用いられる高品質な銅めっき材料への需要が急激に高まっており、今後もこの成長トレンドは継続するものと見込んでいます。また、お客様からは高品質な製品の長期安定供給に対する期待がますます高まっています。

こうした市場環境を踏まえ、当社は本投資を実施し、当製品の製造ラインを新設することを決定しました。これにより、生産能力の増強と安定供給体制の強化を図るとともに、さらなる品質向上と供給信頼性の向上を実現してまいります。当社は、今後も先端材料のグローバルプレーヤーとして、社会の発展と技術革新に貢献してまいります。

以　上

＜参考＞
(※1) プリント基板を貫通する穴。内壁に銅めっきを施すことで、基板の表裏や内部の配線層を電気的に接続する。
(※2) プリント基板の異なる層を電気的に接続する「ビア（微細な穴）」を、銅めっきで充填する技術。
(※3) 半導体の絶縁膜に微細な溝や穴を形成し、銅を埋め込んだ後、表面の余分な銅を研磨・除去することで、銅配線を形成する製造方法。

ＪＸ金属株式会社 コーポレートコミュニケーション部 東京都港区虎ノ門二丁目 10 番 4 号オークラプレステージタワー



高純度硫酸銅「ユピノーグ」

ＪＸ金属株式会社 コーポレートコミュニケーション部 東京都港区虎ノ門二丁目 10 番 4 号オークラプレステージタワー